

Title (en)

ELECTROPLATED AUGMENTATIVE REPLACEMENT PROCESSED CONDUCTORS AND MANUFACTURE THEREOF.

Title (de)

DURCH EIN ELEKTROLYTISCHES AUSTAUSCHVERFAHREN HERGESTELLTE VERBESSERTE LEITER.

Title (fr)

CONDUCTEURS METALLISÉS PAR ELECTROLYSE ET TRAITÉS PAR UN PROCÉDE DE REMPLACEMENT AUGMENTATIF, ET LEUR FABRICATION.

Publication

**EP 0097656 A1 19840111 (EN)**

Application

**EP 82902572 A 19820715**

Priority

US 33680782 A 19820104

Abstract (en)

[origin: WO8302538A1] Electrical conductors (Figures 2 and 4) having enhanced properties (such as increased electrical and thermal conductivity and improved surface characteristics for wire bonding and edge connector insertion in an edge connector) are prepared by applying a mixture (101) of a metallic powder and a polymer on a substrate (100), curing the polymer, effecting an augmentative replacement reaction to replace some of the metallic powder with a more noble metal to form a contiguous layer of a conducting metal (102) on the substrate and thereafter electroplating an additional metal layer (103, 104) on the contiguous layer. Principal use is in manufacture of printed circuits.

Abstract (fr)

Conducteurs électriques ayant des propriétés améliorées (telles qu'une conductivité électrique et thermique améliorée et des caractéristiques améliorées de surface pour liaison de fils électriques et insertion de connecteur de bord dans un connecteur de bord) sont préparés en appliquant un mélange (101) d'une poudre métallique et d'un polymère sur un substrat (100), en laissant polymériser le polymère, en effectuant une réaction de remplacement augmentatif pour remplacer une partie de la poudre métallique par un métal plus noble et former une couche contiguë d'un métal conducteur (102) sur le substrat puis en déposant par électrolyse une couche métallique supplémentaire (103, 104) sur la couche contiguë. Principale application à la fabrication de circuits imprimés.

IPC 1-7

**H05K 1/00**; **B32B 7/10**; **B32B 15/04**; **B32B 33/00**

IPC 8 full level

**H05K 3/18** (2006.01); **H05K 1/09** (2006.01); **H05K 3/24** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H05K 1/095** (2013.01); **H05K 3/246** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB

DOCDB simple family (publication)

**WO 8302538 A1 19830721**; BR 8208045 A 19831122; EP 0097656 A1 19840111; EP 0097656 A4 19860514; JP S59500034 A 19840105

DOCDB simple family (application)

**US 8200956 W 19820715**; BR 8208045 A 19820715; EP 82902572 A 19820715; JP 50255382 A 19820715